

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年12月1日(01.12.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/249262 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/60 (2006.01)

1 六本木ヒルズ森タワー 2 3 階 T M I
総合法律事務所 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/019712

(22) 国際出願日: 2021年5月25日(25.05.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 株式会社新川 (SHINKAWA LTD.) [JP/
JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2
丁目 5 1 番地の 1 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 笠 間 広 幸 (KASAMA, Hiroyuki);
〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1
番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP).

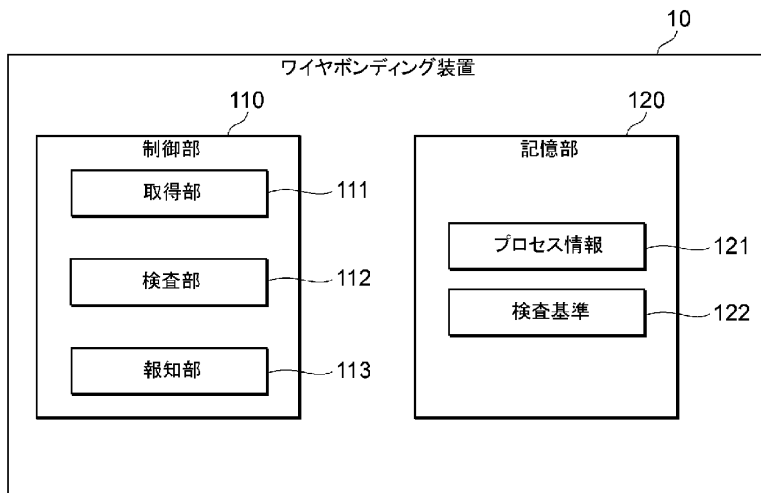
(74) 代理人: 稲葉 良幸, 外 (INABA, Yoshiyuki et al.);
〒1066123 東京都港区六本木 6 - 1 0 -

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,

(54) Title: WIRE BONDING SYSTEM, INSPECTION DEVICE, WIRE BONDING METHOD, AND PROGRAM

(54) 発明の名称: ワイヤボンディングシステム、検査装置、ワイヤボンディング方法、および、プログラム



10 Wire bonding device
110 Control unit
111 Acquisition unit
112 Inspection unit
113 Notification unit
120 Storage unit
121 Process information
122 Inspection criterion

(57) Abstract: A wire bonding system according to the present invention comprises: an acquisition unit that acquires information pertaining to the diameter of a pressure-bonded ball where a wire is pressure-bonded to an electronic component by wire bonding; a first storage unit that stores the information pertaining to the pressure-bonded ball diameter which has been acquired by the acquisition unit; and an inspection unit that inspects the quality of wire bonding on the basis of the information pertaining to the pressure-bonded ball diameter which has been read from the first storage unit. With the wire bonding system, it is possible to enhance convenience in a method for checking the quality of wire bonding.

[続葉有]

MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

規則4. 17に規定する申立て：

- 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て（規則4. 17(v)）

添付公開書類：

- 国際調査報告（条約第21条(3)）
-

(57) 要約：ワイヤボンディングシステムは、電子部品に対してワイヤボンディングによりワイヤが圧着された圧着ボール径に関する情報を取得する取得部と、取得部により取得した圧着ボール径に関する情報を記憶する第1記憶部と、第1記憶部から読み出した圧着ボール径に関する情報に基づいて、ワイヤボンディングの品質を検査する検査部と、を備える。このようなワイヤボンディングシステムにより、ワイヤボンディングの品質の確認方法の利便性を高めることができる。